

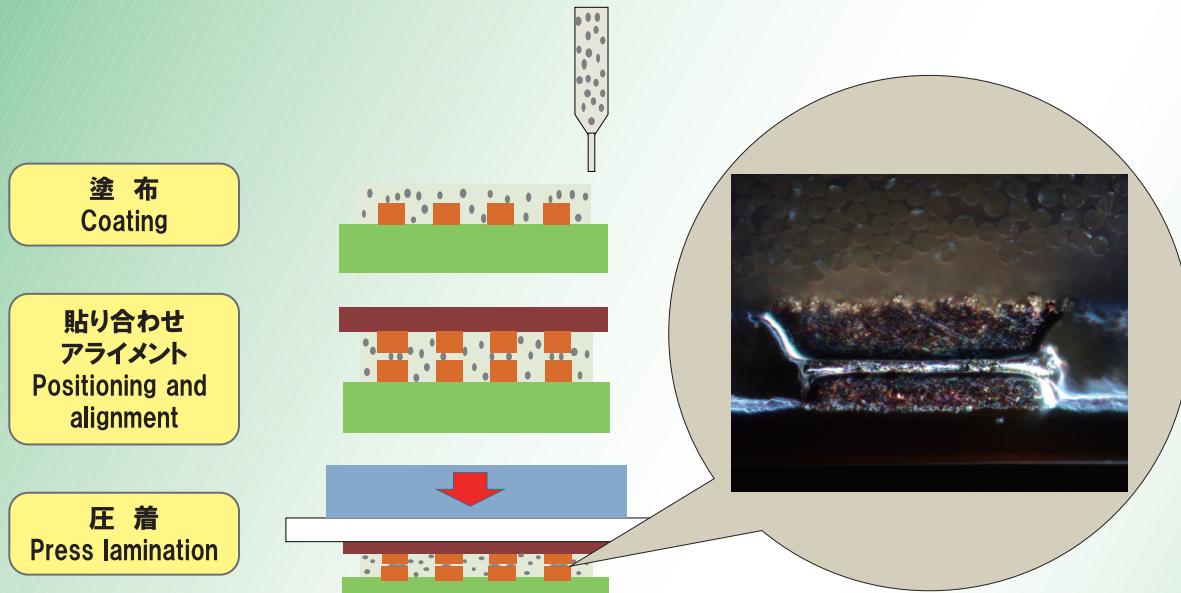


New Product

異方導電性接着剤

Anisotropic Conductive Adhesives

低温かつ低圧で接続可能な異方導電ペースト
Low pressure connection at low temperature.

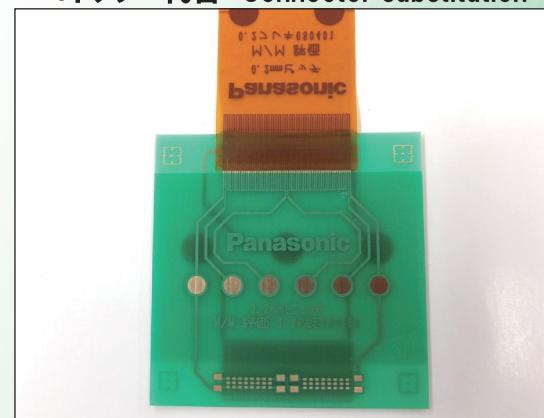


特徴 Features

- 低温短時間での硬化が可能（150°C 6秒硬化） Quick cure at low temperature (150deg.C 6sec.)
- 低圧力での接続が可能（0.8MPa） Low pressure connection (0.8MPa)
- 低背接続（0.1mm） Thin connection (0.1mm)
- リペア接続が可能 Easy reworkability
- 狹ピッチでの接続が可能（50 μm） Accurate connection for narrow-pitch pads

粘度 Viscosity	dPa · s	800
TI		1.3
硬化温度 Curing temp	°C	150
硬化時間 Curing time	秒	6
圧力 Press	MPa	0.8
密着強度 Adhesion	90° peel	20N/cm
絶縁性 Insulation resistance	Ω	1.00E+11

コネクター代替 Connector substitution



本製品は、パナソニック ファクトリーソリューションズ社のライセンスに基づくものです。
This product is licensed by PFSC